

一般社団法人 半導体産業人協会  
理事長 内海忠  
講演企画委員長 遠藤伸裕

## 2018年6月度 SSIS フォーラム開催案内

平素、SSIS フォーラムにご出席いただき、厚くお礼申し上げます。

今回は、車載向けマイコンで世界的なシェアを誇るルネサスエレクトロニクス株式会社の車載向けマイコン事業の統括責任者である服部俊洋様を講師にお迎えして、下記の内容で開催する予定です。

車載半導体ビジネスに関心のある皆様、これからの人間社会の変化に注目される皆様におかれましては、奮ってご出席、ご討論にご参加いただければ幸いです。

### ■ 講演タイトル

「車載向け高性能・高信頼性 SoC/MCU の最新動向

— ”くるま”の変革が社会の変化を、社会の要請が”くるま”の進化を— 」

### ■ 講師

ルネサスエレクトロニクス株式会社

オートモーティブソリューション事業部

車載MCU事業統括部 統括部長

服部 俊洋様

### < 講演要旨 >

昨今の半導体の活用マーケットとして “車載向け半導体”が注目されつつある。車載向け SoC/MCU に対しては、一般半導体と比較して、高信頼性・耐環境性・機能安全・セキュリティ等の特殊な要求事項がある。本発表では、車載半導体に求められるニーズの特殊性とその背景について概説する。また、車載半導体を実現する上での技術的課題、解決策についても述べる。

今、“くるま”自体が変革期を迎えつつある。“くるま”を取り巻く環境、プレーヤの変化についても概説する。電動化、コネクテッド、自動運転というキーワードを実現するために半導体に期待されている部分も大きい。自動運転の分野ではディープラーニング技術が活用されようとしている。

最新の車載半導体をめぐる動向、トピックスについても紹介する。

### < 開催要領 >

1. 日時 2018年6月19日(火) 15時30分～18時
2. 場所 林野会館(文京区大塚3丁目、地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」下車徒歩7分)
3. プログラム  
15時30分～16時45分 講演 (5Fホール)

講師 服部 俊洋氏 (ルネサスエレクトロニクス株式会社)

「車載向け高性能・高信頼性 SoC/MCU の最新動向」

17時～18時 交流会 (6F 604号室)

#### 4. 参加費

SSIS 会員 3,000 円(交流会込み)

一般会員 4,000 円(講演のみ)

6,000 円(講演および交流会)

参加費は当日会場にて申し受けます。なお、会員でない方は当日の入会が可能です。

#### 5. 参加申し込み

SSIS 事務局行 (FAX:03-6457-3246 E-Mail :info@ssis.or.jp でも承ります)

SSIS フォーラム 参加申込票

6月19日(火)のSSISフォーラムに出席します。

お名前:

電話:

所属:

区分: SSIS 会員 [ ]

NEDIA 会員 [ ]

一般 [ ] 講演のみ参加、[ ] 講演および交流会参加



SSIS フォーラムの情報および協会の活動の最新情報は、ホームページでご覧いただけます。

<http://www.ssis.or.jp>